

行政院公告

中華民國113年12月31日
院臺科字第1131033741號

主 旨：修正「國家核心關鍵技術項目及其主管機關」，並自中華民國一百十三年十二月三十一日生效。

依 據：「國家安全法」第三條第三項及「國家核心關鍵技術認定辦法」第六條。

公告事項：附修正「國家核心關鍵技術項目及其主管機關」1份。

院 長 卓榮泰

本則公告之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（<https://gazette.nat.gov.tw/>）。

修正國家核心關鍵技術項目及其主管機關

編號	技術項目	技術 主管機關
1	軍用碳纖維複合材料技術	國防部
2	軍用碳／碳高溫耐燒蝕材料技術	國防部
3	軍用新型抗干擾敵我識別技術	國防部
4	軍用微波／紅外／多模尋標技術	國防部
5	軍用主動式相列偵測技術	國防部
6	衝壓引擎技術	國防部
7	衛星操控技術	國家科學及 技術委員會
8	太空規格 X-Band 影像下載技術	國家科學及 技術委員會
9	太空規格影像壓縮電子單元(EU)技術	國家科學及 技術委員會
10	太空規格 CMOS 影像感測器技術	國家科學及 技術委員會
11	太空規格光學酬載系統之設計、製造與整合技術	國家科學及 技術委員會
12	太空規格主動式相位陣列天線技術	國家科學及 技術委員會
13	太空規格被動反射面天線技術	國家科學及 技術委員會
14	太空規格雷達影像處理技術	國家科學及 技術委員會
15	可運送小衛星入軌之發射載具推進系統設計與製造技術	國家科學及 技術委員會
16	可運送小衛星入軌之發射載具飛行姿態判定與控制技術	國家科學及 技術委員會
17	量子位元設計與製程技術	國家科學及 技術委員會
18	低溫半導體晶片電路設計與製程	國家科學及 技術委員會
19	14 奈米以下製程之 IC 製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術	經濟部

20	異質整合封裝技術-晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術	經濟部
21	毫米波氮化鎵(GaN)功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術	經濟部
22	高頻功率放大器之氮化鎵(GaN)半導體製造技術	經濟部
23	高電壓功率元件之碳化矽(SiC)半導體製造技術	經濟部
24	人工智慧運算之高效能晶片設計技術	經濟部
25	高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術	經濟部
26	二次電池芯-高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術	經濟部
27	晶片安全技術	數位發展部
28	後量子密碼保護技術	數位發展部
29	網路主動防禦技術	數位發展部
30	農業品種育成及繁養殖技術-液體菌種培養技術、水產單性繁殖技術	農業部
31	農業生物晶片技術-農業藥物殘留檢測技術、動植物病原檢測生物晶片技術	農業部
32	農業設施專家系統技術-作物溫室、養殖漁業水環境之設計、營運及維護管理專家系統技術	農業部